

詞彙表

本詞彙表包含本文件所用與本公司及業務有關的若干技術詞彙的解釋。因此，其中部分詞彙及其含義可能與行業標準定義或通用用法存在差異，且可能無法與其他公司採用的類似詞彙進行比較。

「丙烯酸酯」	指	丙烯酸及其衍生物的酯類、鹽類及共軛鹼類物質
「聲學增強材料」	指	專用於智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能可穿戴設備及AI眼鏡／XR設備等消費電子智能終端的專用材料，旨在改善、控制或實現創新的聲學性能
「先進封裝」	指	一系列用於半導體先進制程的創新技術，將多顆晶片與元件整合為單一強大單元，突破傳統封裝技術的限制，實現更優異的性能、更低的功耗與更精巧的體積
「AI」	指	人工智能
「AI眼鏡」	指	集先進計算機視覺、增強現實與人工智能技術於一體的可穿戴設備，旨在提升用戶的視覺體驗，為導航、可視化、無障礙輔助及娛樂等眾多應用提供實時信息、交互式疊加內容及智能輔助
「氧化鋁粉」	指	經研磨、精密分級及除雜等多道工藝加工而成的氧化鋁粉體材料
「CCL」	指	覆銅板，印刷電路板(PCB)的基礎材料，由薄銅箔黏合於玻璃纖維等非導電基板上，浸漬樹脂(如環氧樹脂)後形成剛性基板，用於構建電子電路，並提供電氣絕緣功能及導電銅路徑
「電芯」	指	最小的電池單元

詞彙表

「CMP」	指	化學機械拋光，一種先進的半導體製造工藝，將化學反應與機械研磨相結合，使晶圓表面變得平坦且光滑
「CMP粉體」	指	化學機械拋光粉，指懸浮於液體漿料中的納米級研磨顆粒（如二氧化矽、氧化鋁或氧化鈾），在拋光過程中配合化學藥劑使用，透過化學軟化與機械研磨相結合的方式，使矽晶圓等材料表面達致平滑、平坦的效果
「塗覆」	指	一種通過將摻入陶瓷粉體的糊狀聚合物、熔融態聚合物或聚合物溶液塗覆於薄膜基材來製備複合薄膜的方法
「算力」	指	系統處理數據及執行複雜計算的整體能力，是運行人工智能、數據分析及沉浸式技術等高級應用的基礎
「電子膠粘劑」	指	專用於電子電氣產品的精密膠粘劑，可實現黏接、密封、固定、導熱、導電、絕緣及保護等特定功能
「電子陶瓷粉體」	指	經過精密設計及製備的無機非金屬微細粉末，用於製造電子陶瓷零部件、精密陶瓷結構件及鋰離子電池隔膜塗覆
「電子功能增強材料」	指	專為提升電子設備、元件及電氣系統特定物理性能（包括聲學、散熱／導熱、光學、導電、電磁等）或化學性能而設計的新型先進材料
「EMC」	指	環氧塑封料，一種熱固性複合材料，通常為固態粉體顆粒，由環氧樹脂、硬化劑、二氧化矽填料及添加劑組成，用於在製造過程中封裝並保護敏感電子元件（如晶片），提供關鍵的防潮、耐熱、抗化學腐蝕及抗機械衝擊性能

詞彙表

「環氧樹脂」	指	分子結構中含有兩個或以上環氧基團的聚合物低聚物，其主鏈通常由脂肪族、脂環族或芳香族等有機化合物構成。其可透過環氧基團與各類固化劑發生交聯反應，從而形成具有實際應用價值的熱固性產品
「無機非金屬粉體」	指	一類由氧化物、碳化物、氮化物、鹵化物、硼化物以及矽酸鹽、鋁酸鹽、磷酸鹽、硼酸鹽等物質組成的材料，是除有機高分子材料與金屬材料之外的所有材料的統稱
「kg」	指	千克，國際單位制 (SI) 中質量基本單位，定義為一千克
「LMC」	指	液態模塑料，一種具流動性的聚合物樹脂體系，由樹脂與填料及固化劑混合而成，透過澆注至模具中並固化成型，用於封裝及保護電子元件或製作結構複雜的塑膠部件，可實現精確覆蓋，具備優異的絕緣性能，並提升器件的可靠性
「鋰離子電池」或「LIB」	指	利用鋰離子作為導電離子在正、負極之間移動，並通過化學能與電能的相互轉換實現充、放電的電池
「LIB隔膜塗覆材料」	指	通過精密塗覆技術在鋰離子電池隔膜表面塗覆的功能性材料
「麥克風」	指	可採集音頻信號，並將其傳輸或轉換為數字信號的電子設備，用於實現電子產品的錄音、語音識別、音頻放大或語音指令功能
「模組」	指	應用於光學、聲學及光伏領域，或作為其他電子元件的封裝組件，用於構建更大的系統或設備，對提升電子產品的性能、效率及可擴展性至關重要
「N'BASS材料」	指	N'BASS聲學增強材料，一種特別設計的多孔陶瓷粉體，可構建虛擬背腔，以提升聲學性能

詞彙表

「NPI」	指	新產品導入，指組織內部為定義、開發及推廣新型或改進型產品或解決方案而開展的全流程活動
「PCB」	指	印刷電路板，一種採用絕緣材料（通常為玻璃纖維或複合環氧樹脂）製成的平板，表面有蝕刻銅片形成的導電路徑
「光伏」或「PV」	指	利用具有光伏效應的半導體材料將光能轉化為電能的過程
「光伏背板玻璃塗覆材料」	指	應用於光伏背板玻璃表面的特殊塗覆材料，用於提升光伏組件的發電功率
「研發」	指	研究與開發
「ROIC」	指	投資資本回報率，用以反映公司如何有效運用其所投入的全部資本產生利潤的一項關鍵盈利能力指標
「隔膜」	指	一種置於電池正、負極之間的滲透性薄膜，用於隔離兩個電極防止短路，同時允許在電化學電池中，電流通過時傳輸形成閉合迴路所需的離子電荷載體
「光伏導電漿料」	指	一種黏稠狀漿料，是由高純度(99%)金屬銀微顆粒、黏結劑、溶劑及添加劑通過機械混合而成的物質
「熱導率」	指	衡量材料導熱能力的指標，或指在單位面積及溫度梯度下，熱量通過材料傳遞的速率
「底部填充」	指	底部填充膠，主要採用非接觸噴射式點膠方式，在芯片級封裝(CSP)及球柵陣列(BGA)的底部填充時，可有效降低矽芯片與基板間的衝擊，顯著提升產品耐用性
「UV」	指	紫外線，一種電磁輻射，其波長範圍為10納米至400納米，短於可見光，但長於X射線

詞彙表

「虛擬擴展系數」	指	虛擬後腔擴展系數，作為衡量N'BASS材料能否在不改變腔體物理尺寸的前提下，放大微型揚聲器後腔等效聲學容積的核心量化指標。其計算公式為：等效聲學後腔體積除以實際物理後腔體積
「VOC」	指	揮發性有機化合物，指常溫常壓下任何能揮發並產生危害的有機液體或固體
「晶圓」	指	一種由半導體材料（通常為晶體矽）製成的薄片，作為構建電子電路的基板，需經複雜的晶圓製造工藝加工
「XR」	指	延展實境，泛指一系列沉浸式技術，包括虛擬實境、擴增實境及混合實境，透過電腦生成內容以增強、疊加或取代使用者對物理世界的感知，及／或實現數位內容與實體環境之間的互動
「 μm 」	指	微米，長度計量單位，相當於百萬分之一米